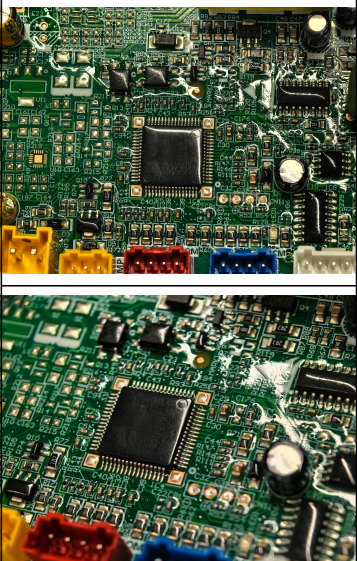
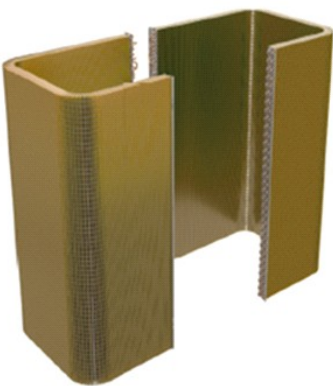


ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT SẢN PHẨM VRF CASPER PHÙ HỢP VỚI CÔNG TRÌNH VEN BIỂN

TT	LINH KIỆN	HÌNH ẢNH	LỚP HẠN CHẾ ẨM MÒN	GHI CHÚ
1	Bảng mạch (PCB)		Phủ lớp keo UV	1. Đặc điểm kỹ thuật của lớp keo UV được phủ trên bảng mạch PCB (VRF CASPER) Độ bám dính cao: phủ đều trên bề mặt linh kiện Chip điều khiển, IC, mối hàn. Độ dày mỏng đồng đều: không ảnh hưởng đến tản nhiệt và tín hiệu điện. Cách điện tốt: nâng cao độ an toàn cho mạch điều khiển. Trong suốt: thuận lợi cho công tác kiểm tra và bảo trì. Chịu môi trường khắc nghiệt: nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, môi trường ngoài trời hoặc ven biển. 2. Tác dụng của lớp phủ keo UV trên PCB (VRF CASPER) Bảo vệ bảng mạch khỏi ẩm, hơi nước và ngưng tụ. Hạn chế ăn mòn hóa học do môi trường có muối, axit hoặc khí ăn mòn. Hạn chế oxy hóa chân linh kiện và đường mạch đồng. Ngăn ngừa phóng điện, rò điện, chập mạch do bụi bẩn hoặc hơi ẩm. Tăng độ ổn định và tuổi thọ cho bo mạch điều khiển.
2	Dàn trao đổi nhiệt		Golden Fin	1. Đặc điểm kỹ thuật của dàn trao đổi nhiệt Golden Fin (VRF CASPER) Cấu tạo dàn trao đổi nhiệt gồm: 2 lớp - Lớp nền nhôm (Aluminium Fin): đảm nhiệm chức năng trao đổi nhiệt. - Lớp phủ hạn chế ăn mòn Đặc tính kỹ thuật chính: Độ bám dính cao: liên kết chắc chắn với bề mặt nhôm. Độ dày mỏng, đồng đều: không cản trở truyền nhiệt. Cách điện bề mặt: hạn chế ăn mòn điện hóa giữa nhôm – đồng. Độ bền thời tiết cao: chịu được mưa, nắng, hơi muối, khí ăn mòn. 2. Cơ chế hạn chế ăn mòn Lớp Golden Fin tạo rào cản ngăn không khí và hơi nước tiếp xúc trực tiếp với bề mặt nhôm, làm chậm quá trình oxy hóa tự nhiên. 3. Ảnh hưởng đến hiệu suất trao đổi nhiệt Khác với các lớp sơn thông thường, Golden Fin trên dàn trao đổi nhiệt VRF Casper được thiết kế: Độ dẫn nhiệt phù hợp, không gây suy giảm đáng kể hiệu suất trao đổi nhiệt trên dàn trao đổi nhiệt. Bề mặt lớp phủ trơn, giảm bám bẩn, giúp luồng gió lưu thông tốt hơn Cải thiện thoát nước, hạn chế đọng nước trên cánh fin → Nhờ đó, hiệu suất dàn ngưng được duy trì ổn định trong thời gian dài.